

OMNIMATE Kryt - řada CH20M CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FE kontakt

Spolehlivá funkčnost - plně integrované nebo jednoduše instalované

Volitelné připojení CH20M FE optimálně chrání váš systém kontaktem na nosné liště pro funkční uzemnění.

- Kontakt pro funkční uzemnění předinstalovaný v 6mm krytu umožňuje trvalé a spolehlivé připojení elektrického stínění elektrického obvodu k nosné liště (např. CH20M6 BP 4P-4P FE BK, 1 164650000)
- Kontakt pro funkční uzemnění, který lze zpracovat plně automaticky metodou pájení přetavením spolu s konektory samci a volitelným sběrníkovým kontaktem, je k dispozici pro kryty od 12,5 do 67,5 mm. Umístění DPS v krytu udává délku pinů 1,5 mm / 3,2 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Objednací číslo	1189370000
Verze	Kryty elektroniky, Příslušenství, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 1, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, Tape
GTIN (EAN)	4032248972715
Mnž.	750 ks
Údaje výrobku	UL:
Balení	Tape

OMNIMATE Kryt - řada CH20M CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,482 g
----------------	---------

Údaje o materiálu

Povrch kontaktu	pocínované
-----------------	------------

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984
-----------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.1	27-18-27-90	eClass 9.0	27-18-27-90

Poznámky

Poznámky	
IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

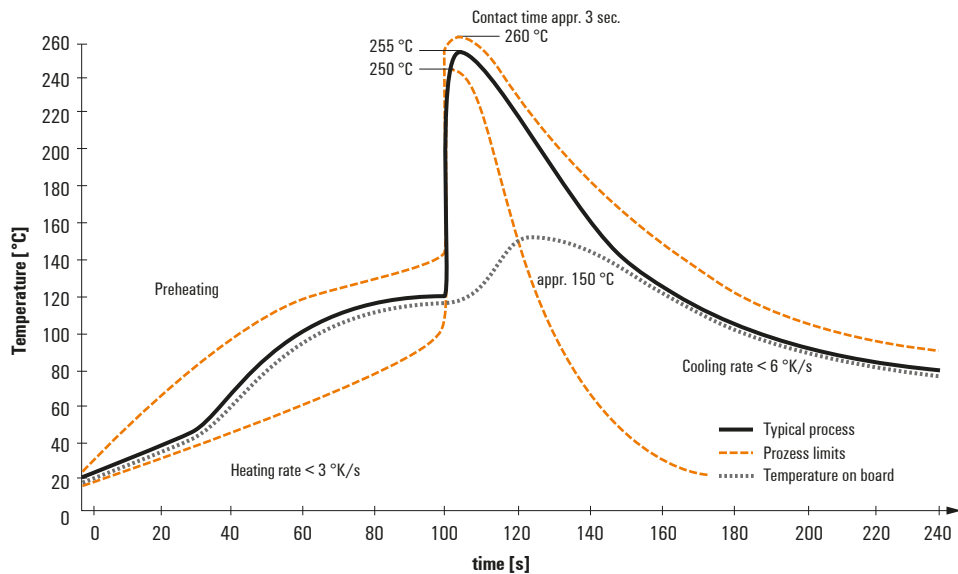
Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Technické údaje	STEP

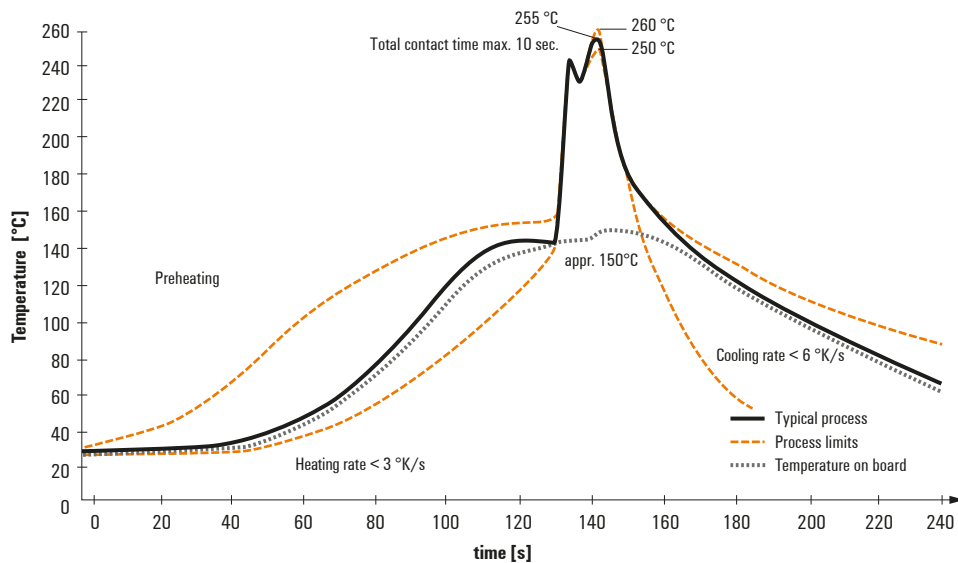
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

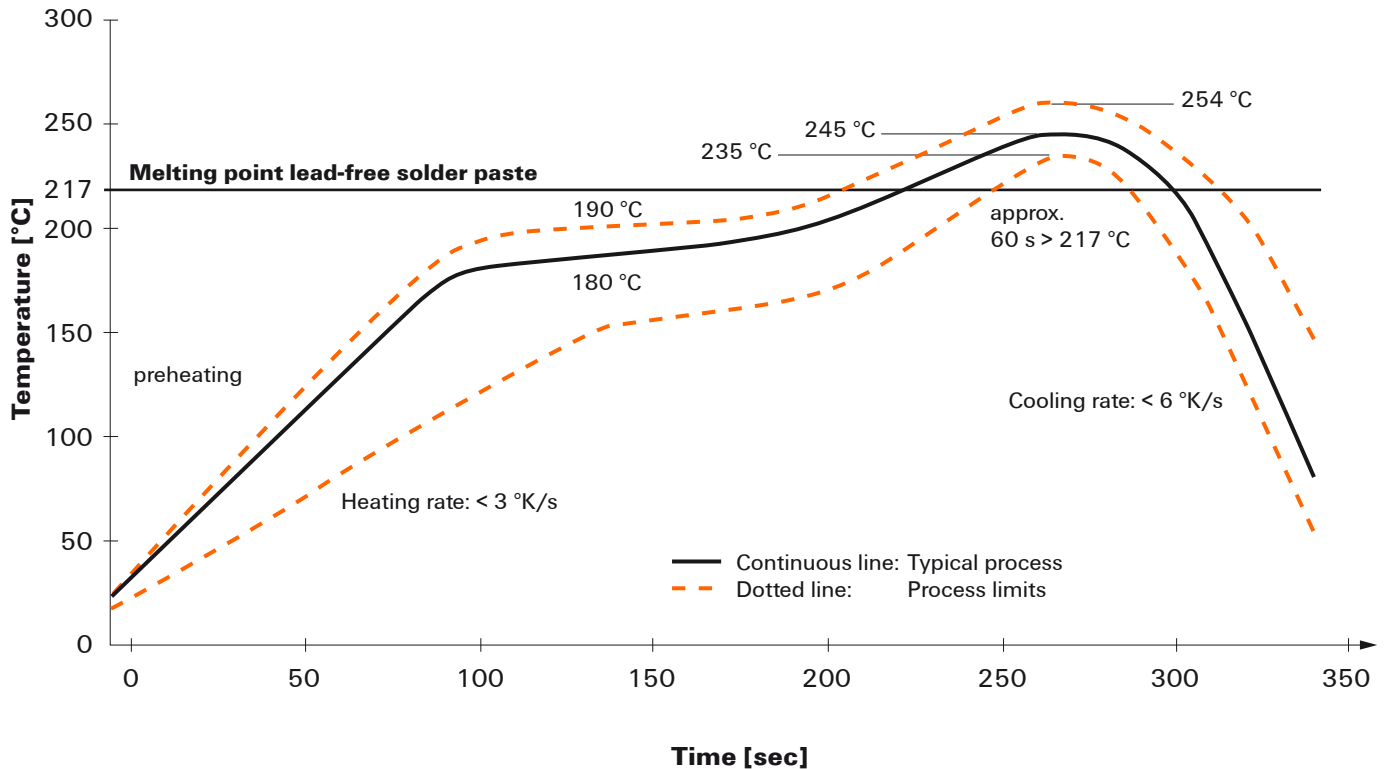
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.